福州达华智能科技股份有限公司

关于公司仲裁进展暨签署款项支付补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")、上海铭朋信息科技 有限公司(以下简称"上海铭朋",更名前为南京铭朋信息科技有限公司)、卡 友支付服务有限公司(以下简称"卡友支付")于近日就卡友支付股权转让事宜 结算产生的各方款项支付做出补充约定,现将主要内容公告如下:

一、本次仲裁事项的基本情况

上海铭朋向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请,请求解除双方就卡 友支付股权转让签署的股权转让协议及补充协议,详情请见公司于2019年2月 1日披露的《关于仲裁事项的公告》(公告编号: 2019-009)。

后双方就仲裁达成一致意见,以和解的方式解决该仲裁事项,并就卡友支付 后续股权收购转让事宜达成一致意见,详情请见公司于2019年12月3日披露的 《关于公司仲裁进展暨签署和解及补充协议的公告》(公告编号: 2019-086)。

二、本次仲裁事项的进展情况

经各方友好协商,就上述《和解协议》及《协议》条款约定,公司陆续向上 海铭朋支付和解款及相应利息,现就《和解协议》及《协议》中约定事项,公司、 上海铭朋、卡友支付就卡友支付股权转让事官结算产生的各方款项支付做出补充 约定如下:

甲方:福州达华智能科技股份有限公司("福州达华")

乙方: 上海铭朋信息科技有限公司 ("上海铭朋")

丙方: 卡友支付服务有限公司("卡友支付")

(以上合称"各方")

(一)上海铭朋同意,在福州达华与卡友支付完全遵守各方在本补充协议签署时已达成或同时达成的各项有效约定的前提下,上海铭朋向福州达华退还部分和解款利息计人民币4,100万元(大写:肆仟壹佰万元整,本补充协议涉及货币均为人民币)。上海铭朋同意将根据各方既有约定项下有权对卡友支付收取的858万元债权以858万元转让给福州达华。

以上两部分对待给付抵销后,上海铭朋同意在本补充协议项下向福州达华实际支付3,242万元(大写:叁仟贰佰肆拾贰万元整),具体的付款时间及条件如下:

- 1、上海铭朋在本补充协议签署后五个工作日内向福州达华支付 1,000 万元 (大写: 壹仟万元整);
- 2、原丙方备案高管变更手续完毕日(以上海铭朋收到福州达华寄送的通知 为准,通知应附有中国人民银行主管行官网作出的行政许可决定信息公示,显示 变更已完成)后的五个工作日内,支付款项1,000万元(大写:壹仟万元整)。
- 3、在满足前述第 2 项付款条件前提下,以 2025 年 12 月 31 日或原丙方分公司人员变更手续完毕日(以上海铭朋收到福州达华寄送的通知为准,通知应附有工商公示信息显示变更已完成)的两者孰晚之日后的五个工作日内,支付剩余款项 1,242 万元(大写: 壹仟贰佰肆拾贰万元整)。
- (二)各方确认,本补充协议系对《和解协议》、裁决书有关和解金额所作调整,不影响各方已达成或同时达成的其他各项有效约定。在甲方、丙方严格履行各方之间签署的其他有效约定项下的义务的情况下,乙方确认将不再要求甲方继续履行原《和解协议》中约定的和解金、利息或违约金的支付义务。
- (三)如福州达华、卡友支付存在任何违反各方已达成或同时达成的各项有 效约定的情形,上海铭朋有权推迟本补充协议约定的款项支付事宜,直至福州达

华、卡友支付完全纠正其违约行为后方才有义务继续履行本补充协议约定的款项支付事宜。如福州达华、卡友支付经上海铭朋通知后拒不纠正其违约行为的,则上海铭朋有权不再支付发出违约纠正通知时本补充协议项下的已到期未付款项以及未到期款项,并有权单方面通知解除本补充协议;如补充协议解除时上海铭朋已经按照本补充协议约定支付部分或者全部款项,则上海铭朋有权要求福州达华立即一次性全额退还已收取的款项,并赔偿上海铭朋已支付款项金额日万分之五利率计算的损失。如上海铭朋未按本协议按期付款,则上海铭朋应向福州达华按未支付款项金额日万分之五利率支付滞纳金。

(四)凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议,由各方友好协商解决;协商不成时,凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议,均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,且可与各方之间届时已签署的、与卡友支付股权转让及其结算相关的其他有效协议涉及争议事项一并仲裁。

(五) 本补充协议正本一式三份,各方各执一份,自各方盖章之日起生效。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除上述重大仲裁案件外,公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次款项支付补充协议的签订,对公司后期利润产生一定的影响,具体影响金额以会计师年度审计结果为准,公司将及时履行相关的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《关于款项支付的补充协议》

特此公告。

董事会 二〇二五年十月十八日